下载日志已记录，仅供内部参考

国投证券 SDIC SECURITIES

2026 年 08 月 30 日
电子

行业周报

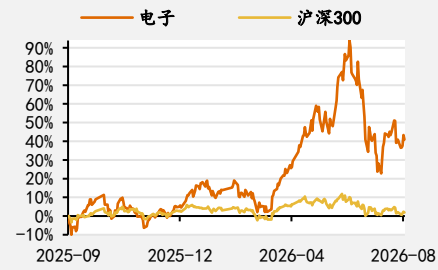
证券研究报告

Groq 3 LPX 全面投产，三星电机调涨 MLCC 报价

投资评级 领先大市-A
维持评级

首选股票	目标价（元）	评级

行业表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	4.5	-4.8	38.2
绝对收益	5.3	-11.0	41.5

常思远 分析师
SAC 执业证书编号：S1450525120001
changsy1@sdicsc.com.cn

相关报告

三星据悉上调芯片代工价格，OpenAI 与英伟达拟建设世界级 AI 工厂	2026-08-23
SK 海力士扩大中国 NAND 产能，矽品扩产 CoWoS	2026-08-16
SK 海力士扩张芯片业务，应用光电计划大幅扩产	2026-08-08
英伟达与博通 CPO 交换机小量出货，三星电机 MLCC 出货价统一上调	2026-08-01
谷歌上修 26 年资本支出，台积电拟涨价至多 10%	2026-07-25

英伟达发布 Scale-In 概念，Groq 3 LPX 全面量产

据半导体行业观察 8 月 26 日消息，NVIDIA 正在推出 Scale-In 网络基础设施，这是 NVIDIA AI 网络的第五大支柱，旨在为智能体人工智能工厂提供专用的加速功能，以保障其安全、管理和运行。Scale-In 将南北向网络演进为 AI 工厂构建一个协调的基础设施域。Scale-In 由 NVIDIA BlueField-4 和 NVIDIA DOCA 提供支持，并通过 NVIDIA Spectrum-X 以太网连接，可加速保障整个 AI 堆栈安全运行的服务，并在整个 AI 工厂内传输应用程序、数据和存储流量。专用的、独立于主机的处理能力使这些基础设施服务摆脱了主机 CPU 的束缚，从而有助于防止安全性、数据访问和运维在 AI 计算规模扩大时成为瓶颈。最终，随着需求的增长，用户可以获得更安全、更高效的共享 AI 基础设施，并持续访问 AI 服务和数据。同时，英伟达在 Hot Chips 大会上宣布，其交互式 AI 推理加速器 NVIDIA Groq 3 LPX 现已全面量产。作为 NVIDIA Vera Rubin 平台的扩展，Groq 3 LPX 通过实现超快的 Token 生成速度，大幅提升了 AI 推理性能，从而为高度响应的智能体系统提供强力支持。

三星电机调涨 4Q26 OEM 报价，开启 MLCC 产业上升周期

据 TrendForce 集邦咨询最新 MLCC 产业研究，韩国大厂 SEMCO（三星电机）近期率先针对 OEM、ODM 客户调涨 2026 年第四季报价，意味着 MLCC 产业正式迈入上升格局。TrendForce 集邦咨询预估，SEMCO 将对 OEM、ODM 客户平均上调消费级 X5R 产品价格 25%至 30%，借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。受惠消费级中高容订单外溢效应，其他厂商第四季报价维持上升态势，预估平均涨幅达 10%至 20%，以消费级中高容产品为主要涨价标的。厂商产能稼动率同步提高，部分供应商已接近九成。此外，由于 AI 数据中心需求持续强劲，光通信模块供货缺口扩大，连带导致 MLCC 需求吃紧，相关厂商也积极寻求支持。TrendForce 集邦咨询表示，随着消费级中高容订单向其他厂商外溢，稼动率垫高，而且 SEMCO 调涨报价，MLCC 产业正式迈入涨价循环。Murata、Taiyo Yuden 等日厂是否会跟进，成为观察下一波涨幅的重要指标，预估第四季将延续 MLCC 供需缺口扩大、价格走升的态势。

谷歌发布 TPU v8 双芯片，推理训练芯片拆分

据 ServeTheHome 8 月 26 日消息，在 Hot Chips 2026 大会上，谷歌详细介绍了其第八代张量处理单元（TPU）家族，包括用于训练的 TPU

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

8t 和用于推理的 TPU 8i。这一发布标志着谷歌在自研 AI 硬件上的持续投入,使其成为少数同时开发训练和推理芯片的超大规模云厂商之一。本次发布的 TPUv8 家族有两个显著特点：一是首次在单一年份推出两款芯片，而非交替发布；二是设计时更多考虑云客户的工作负载，而不仅限于内部任务。谷歌指出，混合专家（MoE）模型带来了新的瓶颈，因为其通信和网络流量远高于早期模型，单纯提升 FLOPS 已不足以应对。此外，新硬件针对 agentic AI 的长上下文窗口进行了优化。值得注意的是，TPU 8i 与谷歌自研的 Axion CPU 搭配使用，比例为 2:1，取代了此前使用的 x86 CPU，这标志着谷歌在硬件上全面转向自研和 Arm 架构。这一举措进一步减少了对外部供应商的依赖。

电子本周上涨 0.15%（26/31），10 年 PE 百分位为 97.97%

（1）本周（2026.08.24-2026.08.28）上证指数上涨 1.20%，深证成指下跌 1.00%，沪深 300 指数下跌 0.21%，申万电子版块上涨 0.15%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 26/31。

（2）本周(2026.08.24-2026.08.28)电子版块涨幅前三公司分别为捷荣技术（44.24%）、超频三（33.21%）、赛微电子（28.70%），跌幅前三公司分别为骏成科技（-15.46%）、世华科技（-13.77%）、信濠光电（-13.50%）。

（3）PE：截至 2026.08.28，沪深 300 指数 PE 为 13.70 倍，10 年 PE 百分位为 73.68%；SW 电子指数 PE 为 80.47 倍，10 年 PE 百分位为 97.97%。

投资建议：

国产替代：建议关注盛合晶微、中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司、拓荆科技等；**国产算力：**建议关注芯原股份、寒武纪、华勤技术、杰华特等；**CPO/OCS:**建议关注天孚通信、炬光科技、新易盛等；**玻璃基板：**建议关注京东方、沃格光电、天承科技、德龙激光、帝尔激光等

风险提示：

国产替代不及预期；技术突破不及预期；下游景气度不及预期；行业竞争加剧。

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

内容目录

1. 下周科技前瞻 4
2. 本周新闻一览 5
3. 行业数据跟踪 6
3.1. 新能源汽车 6
3.2. 消费电子 6
4. 本周行情回顾 8
4.1. 涨跌幅：电子排名 26/31，电子指数上涨 0.15% 8
4.2. PE：电子指数 PE 为 80.47 倍，10 年 PE 百分位为 97.97% 9
5. 新股日历 11

图表目录

图 1. 新能源汽车产销量情况 6
图 2. 国内智能手机月度出货量（万台） 6
图 3. 国内智能手机月度产量（万台） 6
图 4. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额 7
图 5. 本周各行业版块涨跌幅（申万一级行业分类） 8
图 6. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万二级行业分类；%） 8
图 7. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万三级行业分类） 8
图 8. 本周电子版块涨幅前十公司（%） 9
图 9. 本周电子版块跌幅前十公司（%） 9
图 10. 电子版块近十年 PE 走势 9
图 11. 电子版块近十年 PE 百分位走势 9
图 12. 电子版块子版块近十年 PE 走势 10
图 13. 电子版块子版块近十年 PE 百分位走势 10

表 1： 下周重要事件一览 4
表 2：本周电子行业新闻一览 5
表 2： 新股 IPO 审核状态更新 11

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

1. 下周科技前瞻

表1：下周重要事件一览

8 月 31 日
➢ **第十四届半导体设备材料及核心部件展：**将于 8 月 31 日-9 月 2 日在无锡太湖国际博览中心举办举行，将围绕半导体设备、核心部件、关键材料、先进工艺、先进封装、智能制造、产教人才等议题，通过展览展示、专业论坛、技术发布及产业对接等形式，探索产业高质量发展的新路径。
9 月 2 日
➢ **SEMICON 台湾 2026：**将于 9 月 2-4 日在台北 TaiNEX 1 号和 2 号馆举行，今年将重点关注先进制造、异质集成、化合物半导体、汽车芯片、智能制造、可持续发展、半导体网络安全与人才队伍等行业主题。
9 月 4 日
➢ **中国国际消费电子博览会：**将于于 2026 年 9 月 4-6 日在青岛国际会展中心（红岛馆）举行，将集中展示智能家居家电、人工智能、低空经济、智慧康养、新型显示、虚拟现实等领域的新产品新技术。

资料来源：CSEAC 官网、SEMICON 官网、电博会官网、国投证券证券研究所整理

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

2. 本周新闻一览

表 2：本周电子行业新闻一览

赛道	日期	来源	内容
半导体	8 月 24 日	半导体投资联盟公众号	8 月 24 日，中微公司对外预告，将于第十四届半导体设备材料及核心部件展（CSEAC 2026）期间举办新品发布会，推出刻蚀、薄膜、MOCVD 等多款高端设备。此次拟发布新品，覆盖集成电路微观加工高端设备多个关键领域。刻蚀设备是芯片制造中实现纳米级图形转移的核心装备，薄膜沉积设备用于在晶圆表面逐层构建导电或绝缘膜层，MOCVD 设备则是氮化镓、砷化镓等化合物半导体外延生长的关键设备，广泛应用于功率器件、射频芯片及光电子器件制造。按照披露信息，本次拟发布的多款新品，有望在工艺精度、产能效率和国产化适配等方面实现显著提升。其中刻蚀设备定位面向先进逻辑和存储芯片的严苛制程要求，薄膜沉积设备拟进一步拓展在先进封装和三维集成领域的应用边界，MOCVD 设备针对化合物半导体快速增长的市场需求开展性能升级。
AI	8 月 27 日	财联社官网	8 月 26 日晚，阿里发布并同步开源千问最新模型 Qwen3.8-Flash。这款采用全新下一代架构的多模态混合专家（MoE）模型，以千亿总参数仅激活 60 亿（6B）的超高效率，在多项评测中超越 Claude Opus4.6、接近 Opus4.8。更关键的是，它的推理定价仅为每百万 Tokens 输入 0.8 元，输出 2.7 元，不到 Opus4.6 的 1/40，比 DeepSeek-V4-Flash 忙时价格的 1/3 还低。Qwen3.8-Flash 的出现，将悄然重划大模型的“斩杀线”——从 Token 单价走向任务总成本，从“谁能做出最强的模型”转向“谁能用最低成本交付足够强的智能”。这一转变，或将重塑上游硬件产业的竞争逻辑。未来决定推理效率的，将不再只是 GPU 的 FLOPS 峰值，还涵盖 HBM 容量与带宽、CPU 与 GPU 间的互联速度、KV Cache 管理效率，以及推理框架能否有效减少数据搬运等。大模型的竞争，正从单一的算力比拼，走向模型架构、芯片、内存与推理系统深度协同的多维角逐。
	8 月 27 日	半导纵横公众号	AWS 与英伟达再次扩大合作。双方宣布，AWS 将在 2027 年至 2028 年新增部署 200 万块英伟达 GPU，使此前已经宣布的 100 万块 GPU 计划进一步扩大至 300 万块。与此同时，合作范围也从 GPU 进一步延伸到 CPU、内存、网络、开放模型、数据处理和机器人等多个环节。
SiC	8 月 27 日	集邦化合物半导体公众号	近日，南京晶升装备股份有限公司自研的大尺寸 CVD-SiC 化学气相沉积涂层成套设备顺利通过整机出厂检验，已经装车发运交付下游客户。新产品落地，标志着晶升股份业务版图从碳化硅长晶设备，进一步延伸至热场部件涂层工艺装备领域，为半导体关键零部件国产化提供新的设备选项。据介绍，这款 CVD-SiC 涂层设备集成多项自研技术。创新的进气结构可以优化气流路径，减少腔体内异常沉积现象，保障工艺长期稳定运行；依托热场-气流协同控制、多温区耦合调控方案，沉积环境均匀性得到提升。设备增设副产物定向捕获区域，降低腔体污染风险，拉长连续生产周期；定制化供料控制系统保障源气体输送稳定。同时在排气管路、维护结构上进行优化，减少副产物附着，缩短设备停机保养时长。
汽车电子	8 月 29 日	川土微电子官网	近日，上海川土微电子有限公司完成了数亿元 C 轮和 C+轮融资，该轮融资由比亚迪股份、上汽集团战略直投基金及旗下尚颀资本联合领投，磐霖资本、朗玛峰创投、元禾璞华、中汇金资本等老股东继续跟投。本轮融资，将用于进一步提升核心技术及车规芯片等关键产品的迭代升级与新产品的研发，引进高端研发人才，优化产品性能，巩固现有产品线的市场地位。
消费电子	8 月 27 日	Counterpoint 咨询公众号	根据 Counterpoint Research 最新《全球手机型号销量追踪》，苹果 iPhone 17 在 2026 年第二季度成为全球最畅销智能手机，占全球智能手机销量的 6%。苹果和三星各有 5 款机型进入前十榜单，合计占全球智能手机销量的 26%，同比增长 2%。尽管整体市场下降 11%，各品牌在应对全球 RAM 短缺之际将重点转向高端和主力机型，前十机型的销量贡献率依然保持高位。
存储	8 月 24 日	电子工程专辑公众号	谦合益邦宣布其自主研发的全球首款 4 层 3D DRAM 堆叠存算一体芯片成功回片，该芯片以逻辑层为基底、4 层 DRAM 堆叠其上的"4+1"三维堆叠架构将计算单元与存储单元在三维空间中深度融合，从根本上突破了传统平面架构下计算与存储分离带来的"内存墙"瓶颈。

资料来源：国投证券证券研究所整理

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

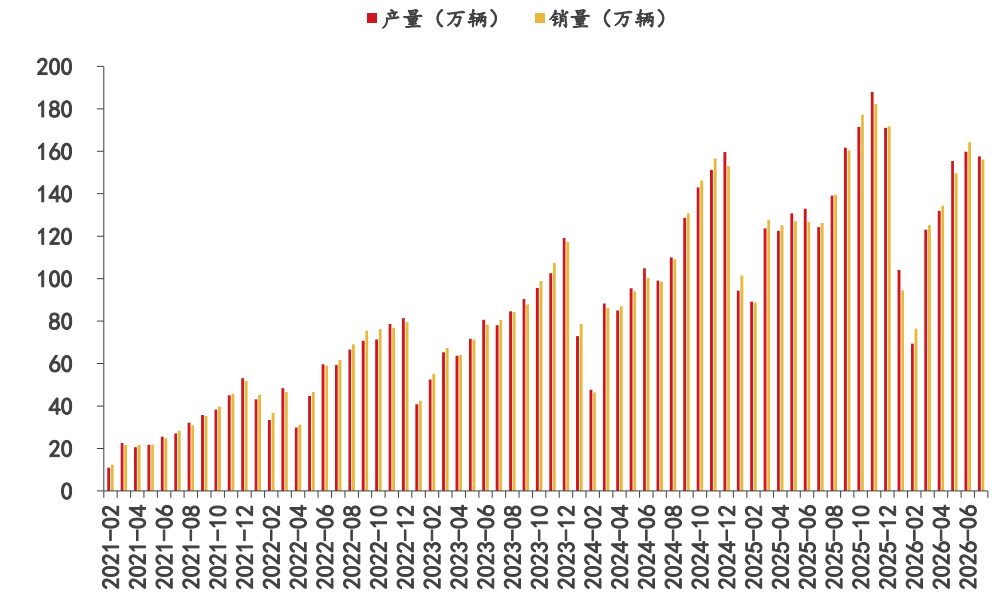
下载日志已记录，仅供内部参考

3. 行业数据跟踪

3.1.新能源汽车

由中汽协公布的新能源车产销量数据，2026 年 7 月，新能源汽车产销分别完成 157.6 万辆和 156.1 万辆，分别同比增长 26.8%和 23.7%。

图1.新能源汽车产销量情况



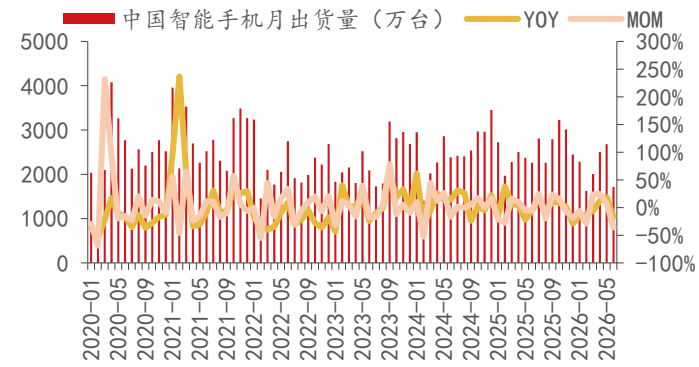
资料来源：中国汽车工业协会，wind，国投证券证券研究所

3.2.消费电子

智能手机：据中国信通院数据显示，2026 年 6 月，国内市场手机出货量 1914.9 万部，同比下降 15.3%，其中，5G 手机 1620.1 万部，同比下降 12.1%，占同期手机出货量的 84.6%；智能手机出货量 1714.9 万部，同比下降 16.6%，占同期手机出货量的 86.6%。

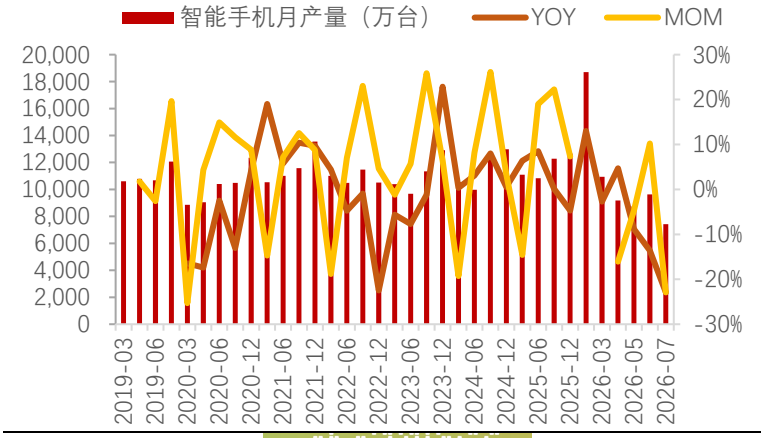
根据国家统计局数据，2026 年 7 月我国智能手机产量为 7426 万台，同比减少 22.9%。

图2.国内智能手机月度出货量（万台）



资料来源：中国信通院，国投证券证券研究所

图3.国内智能手机月度产量（万台）



资料来源：国家统计局，国投证券证券研究所

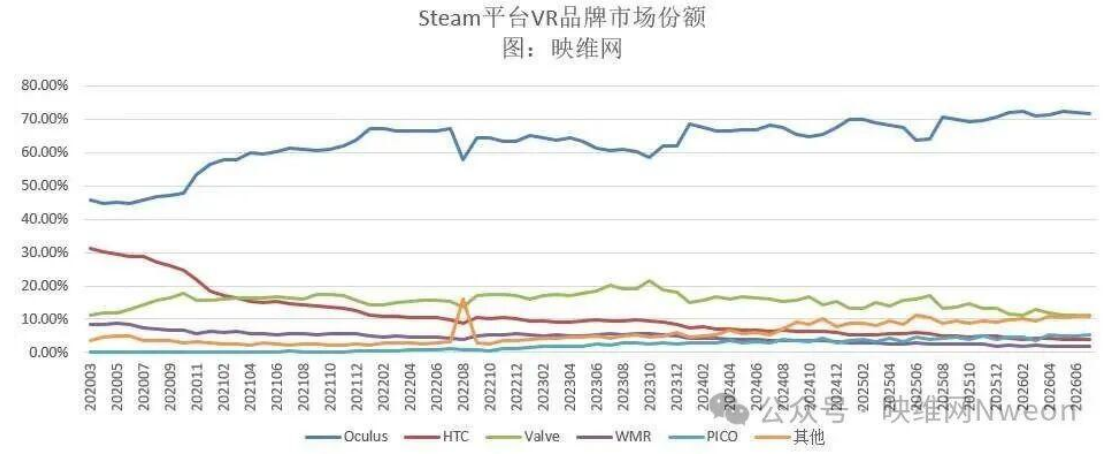
VR：据映维网公众号，Valve 公布了 2026 年 7 月份的 Steam 硬件和软件调查数据。其中，VR 头显在 Steam 用户中的总占比增加 0.18 个百分点至 1.71%。在头显方面，Meta 旗下的 Quest 3 和 Quest 3S 均出现大幅下滑。在头显细分方面，Meta 家族在 7 月出现了大幅变化。其中，Quest 2 以 26.66%的份额重夺榜首，环比大幅增长+3.12%。另一方面，Quest 3 环比大

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

幅减少 1.73%至 26.25%，而 Quest 3S 则是环比下降-1.55%至 11.44%。Quest 3/3S 合计环比暴跌 3.28%。

图4.Steam 平台主要 VR 品牌市场份额



资料来源：映维网官方公众号，国投证券证券研究所

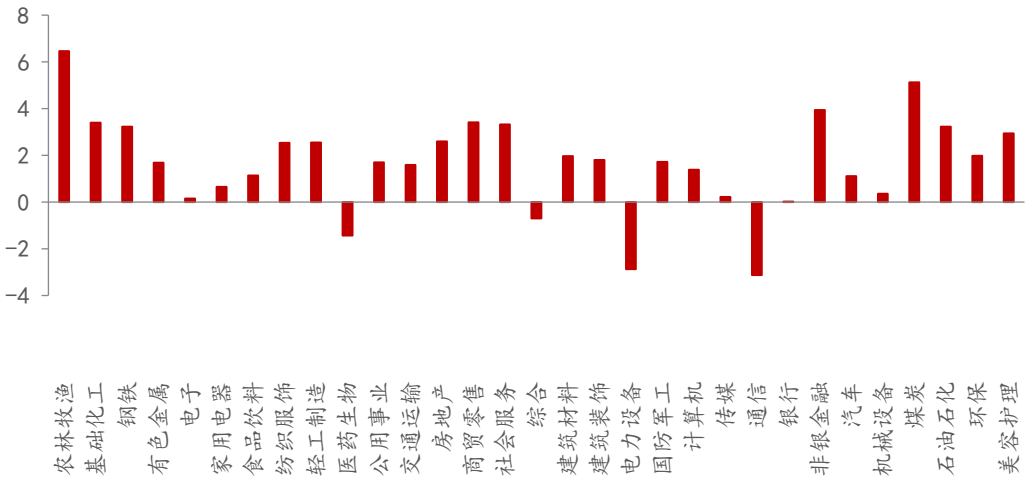
下载日志已记录，仅供内部参考

4. 本周行情回顾

4.1. 涨跌幅：电子排名 26/31，电子指数上涨 0.15%

- **全行业：**本周（2026.08.24-2026.08.28）上证指数上涨 1.20%，深证成指下跌 1.00%，沪深 300 指数下跌 0.21%，申万电子版块上涨 0.15%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 26/31。

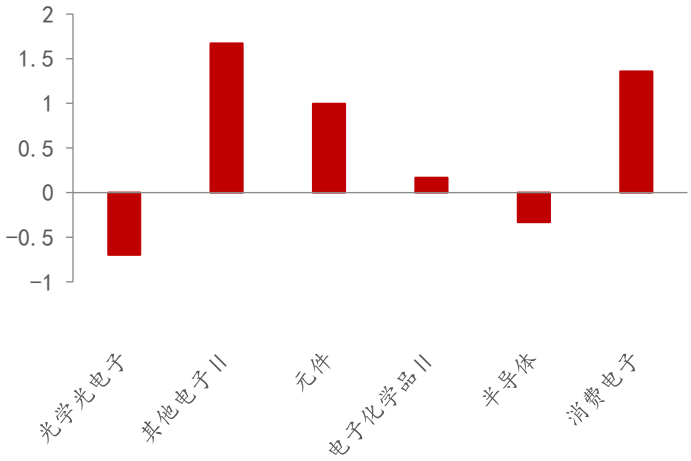
图5.本周各行业版块涨跌幅（申万一级行业分类）



资料来源：Wind，国投证券证券研究所

- **电子行业：**本周（2026.08.24-2026.08.28）其他电子涨幅最大，为 1.67%；光学光电子跌幅最大，为-0.70%。

图6.本周电子版块子版块涨跌幅（申万二级行业分类；%）



资料来源：Wind，国投证券证券研究所

图7.本周电子版块子版块涨跌幅（申万三级行业分类）

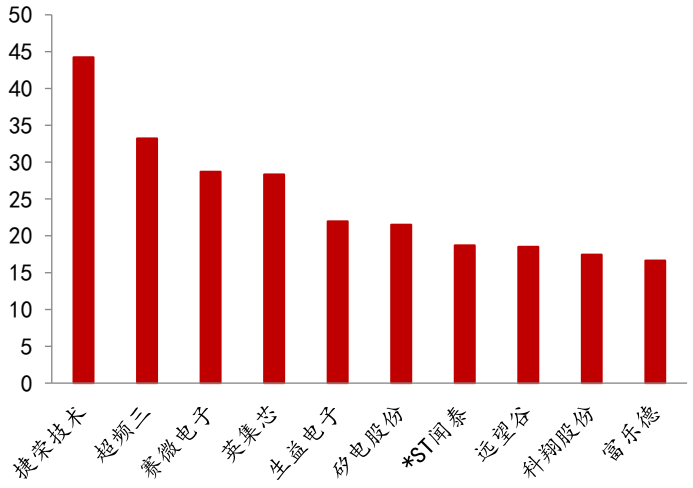
申万二级行业名称	周涨跌幅（%）	申万三级行业名称	周涨跌幅（%）
半导体	-0.33	分立器件	-2.05
		半导体材料	-1.18
		数字芯片设计	-0.04
		模拟芯片设计	0.32
		集成电路封测	-2.10
		半导体设备	-0.68
元件	1.00	印制电路板	1.36
		被动元件	-0.48
光学光电子	-0.70	面板	-1.17
		LED	-1.06
		光学元件	0.46
其他电子	1.67	其他电子III	1.67
消费电子	1.36	品牌消费电子	0.22
		消费电子零部件及组装	1.46
电子化学品	0.17	电子化学品III	0.17

资料来源：Wind，国投证券证券研究所

- **电子标的：**本周（2026.08.24-2026.08.28）电子版块涨幅前三公司分别为捷荣技术（44.24%）、超频三（33.21%）、赛微电子（28.70%），跌幅前三公司分别为骏成科技（-15.46%）、世华科技（-13.77%）、信濠光电（-13.50%）。

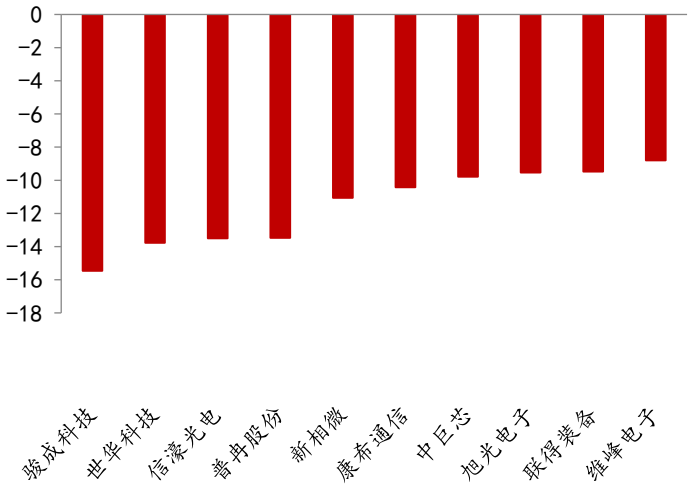
下载日志已记录，仅供内部参考

图8.本周电子版块涨幅前十公司（%）



资料来源：Wind，国投证券证券研究所

图9.本周电子版块跌幅前十公司（%）

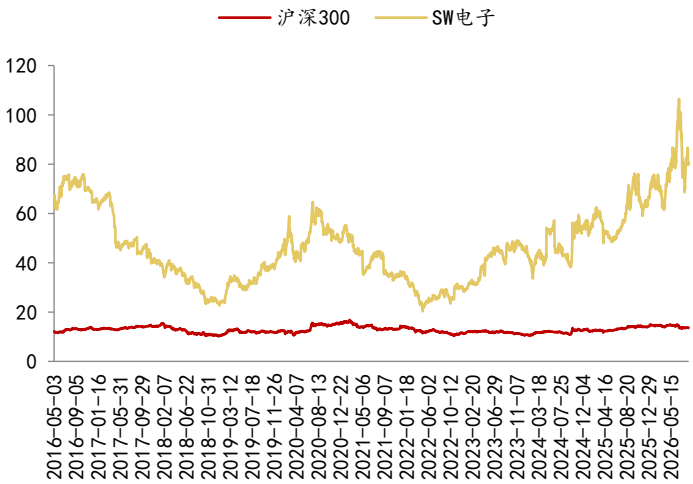


资料来源：Wind，国投证券证券研究所

4.2. PE：电子指数 PE 为 80.47 倍，10 年 PE 百分位为 97.97%

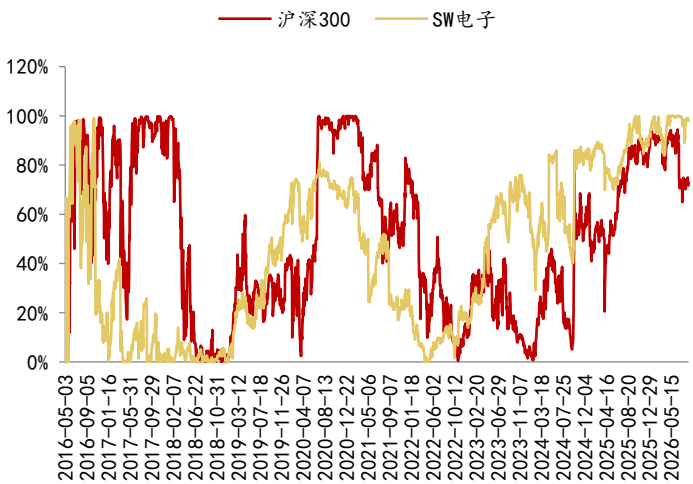
- **电子行业**：截至 2026.08.28，沪深 300 指数 PE 为 13.70 倍，10 年 PE 百分位为 73.68%；SW 电子指数 PE 为 80.47 倍，10 年 PE 百分位为 97.97%。

图10.电子版块近十年 PE 走势



资料来源：wind，国投证券证券研究所

图11.电子版块近十年 PE 百分位走势



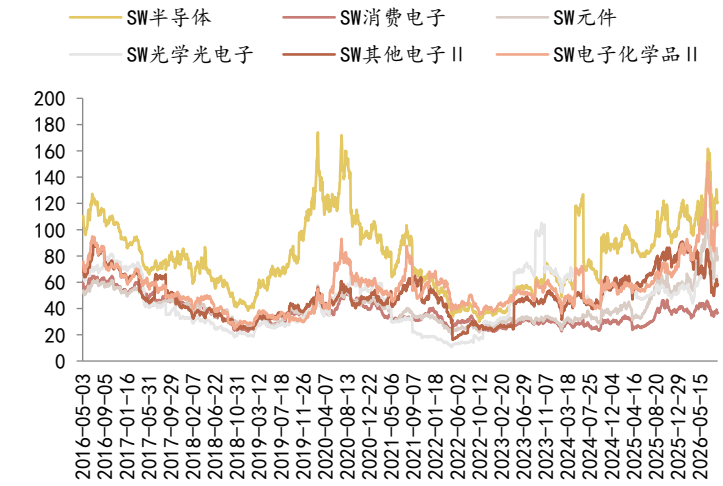
资料来源：wind，国投证券证券研究所

- **电子行业子版块**：截至 2026.08.28，电子行业子版块 PE/PE 百分位分别为半导体（118.68 倍/91.12%）、消费电子（37.38 倍/60.37%）、元件（80.39 倍/98.05%）、光学光电子（60.84 倍/78.30%）、其他电子（60.12 倍/74.83%）、电子化学品（103.61 倍/98.19%）。

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

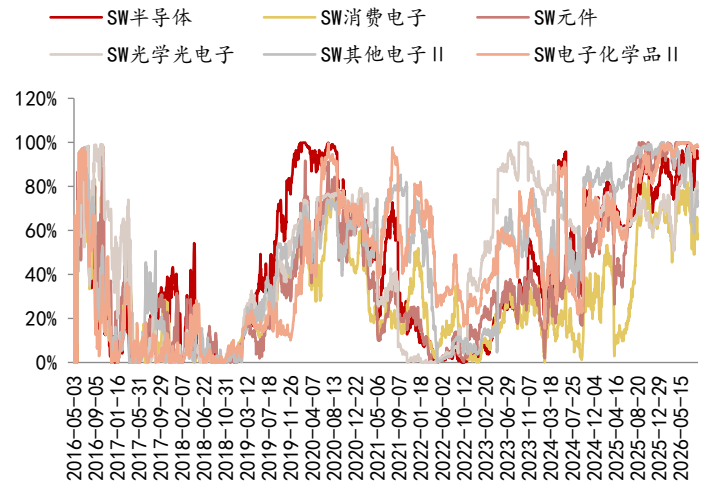
下载日志已记录，仅供内部参考

图12.电子版块子版块近十年 PE 走势



资料来源：wind，国投证券证券研究所

图13.电子版块子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源：wind，国投证券证券研究所

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

5. 新股日历

表2：新股 IPO 审核状态更新

	8.31	9.01	9.02	9.03	9.04
招股					
路演					
询价					
发行公告		燧原科技 688801.SH			
申购			燧原科技 688801.SH		
公布中签率				燧原科技 688801.SH	
中签结果					燧原科技 688801.SH
上市					

资料来源：Wind，国投证券证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

行业评级体系

收益评级：
领先大市 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%及以上；
同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；
落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上；
风险评级：
A —— 正常风险，未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；
B —— 较高风险，未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。

下载日志已记录，仅供内部参考

免责声明

何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

国投证券证券研究所

深圳市
地　址：深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 33 层
邮　编：518046

上海市
地　址：上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 28 层
邮　编：200082

北京市
地　址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层
邮　编：100034